## 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、审议通过了《关于公司首次 公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发 行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案,现将有关情 况公告如下:

为深化国际化战略布局,增强境外投融资及运营能力,持续吸引并聚集优秀人 才,进一步提升公司综合竞争实力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等相关法律、法规的规定,公司拟在境外发行股份(H股)并在香 港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次发行 上市"),公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 上市。

根据A股上市公司发行H股并在香港联交所上市的相关规定,公司本次发行上 市尚需提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港 证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

截至目前, 公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨, 除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。

本次发行上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。 公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的规定,根据本次 发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会 2025年11月22日